

2009年10月23日  
仲谷マイクロデバイス株式会社  
アムコアテクノロジー社  
株式会社東芝

### 半導体後工程の合併事業化について

仲谷マイクロデバイス株式会社（以下、NMD）、米・アムコアテクノロジー社（Amkor Technology Inc. 以下、アムコア）および株式会社東芝（以下、東芝）は、2009年4月28日の基本合意に基づき、アムコアと東芝がNMDに出資することについて合意し、契約を締結しました。

なお、本出資に伴い、NMDは2009年10月31日付で株式会社ジェイデバイス（以下、ジェイデバイス）に社名変更する予定です。

東芝は、グループ会社である東芝LSIパッケージソリューション株式会社（以下、TPACS）におけるシステムLSI後工程事業および同技術開発業務をNMDに譲渡するとともに、大分事業所のシステムLSI・メモリ後工程設備、福岡事業所のシステムLSI後工程設備、並びに東芝の大分工場のウエハーテスト設備を、NMDおよびアムコアに譲渡します。なお、TPACSで当該部門に従事している従業員は、ジェイデバイスにおいて業務に従事する予定です。

アムコアは、ジェイデバイスに対し半導体後工程設備のリースを行い、2012年以降ジェイデバイスの株式の過半数以上を取得する権利（コールオプション）を持ちます。

ジェイデバイスは、NMDの低コストオペレーションとアムコアの持つ製造技術力とグローバルな部材調達力およびTPACSのもつ先端技術力をベースにした国内最高水準の後工程サービスを全てのお客様に提供し、半導体後工程専門メーカーとして、日本半導体産業全体の後工程プラットフォームになることを目指します。

#### 【株式会社ジェイデバイス概要】

所在地：大分県臼杵市福良1913-2  
代表者：仲谷 善文（代表取締役社長）  
業務内容：半導体後工程（組立、テスト等）  
資本金：17億7千万円  
出資比率：NMD既存株主60%、アムコア30%、東芝10%

#### 【報道関係者お問い合わせ先】

仲谷マイクロデバイス株式会社 営業部	TEL：050-3161-4917
株式会社東芝 広報室	TEL：03-3457-2100
アムコアテクノロジー社	TEL：+1-480-821-5000 内線 5416
	email: jsolo@amkor.com